

## 1. ARBEITSTAGE (Montag bis Freitag, Ausnahme sind Feier- und Brückentage)

1.1. Für Aufträge mit vollständigen Fertigungsdaten, die bis 18:00 Uhr eines Arbeitstages zur Verfügung gestellt werden, gilt der darauf folgende Arbeitstag als erster Arbeitstag.

**Ausnahme:** Wird die Bestellung an einem Samstag, Sonntag, Feiertag oder Brückentag platziert, gilt der übernächste Arbeitstag als erster Arbeitstag.

Für Aufträge mit vollständigen Fertigungsdaten, die nach 18:00 Uhr zur Verfügung gestellt werden, gilt der übernächste Arbeitstag als erster Arbeitstag.

1.2. Technische Voraussetzungen: Produktionsdaten und Aufträge, die fehlerhaft, unvollständig oder von den Angaben, auf denen das Angebot basiert, abweichen, führen zu Lieferverzögerungen und/oder falschen Ausführungen.

## 2. HAFTUNGSFREISTELLUNG

Bei Bezug auf ein Angebot oder auf eine Anfrage und für die daraus resultierenden Fehler übernimmt die MicroCirtec GmbH keine Verantwortung.

## 3. SEITENRICHTIGKEIT

3.1. Um die Seitenrichtigkeit (gespiegelte oder ungespiegelte Ansicht) der Leiterbilder erkennen zu können, muss ein lesbarer Schriftzug in dem Leiterbild einer Außenlage enthalten sein.

3.2. Bei Multilayern muss die Reihenfolge des Lagenaufbaus angegeben werden. Ohne diese Angaben übernimmt die MicroCirtec GmbH keine Haftung für die richtige Ausführung.

## 4. VERWECHSLUNG

Ist kein Infotext für die Beschreibung der Dateien vorhanden, kann die MicroCirtec GmbH nicht für eine eventuell falsche Ausführung der Leiterplatte in Haftung genommen werden.

## 5. KONVERTIERUNG

Für Fehler, die durch die Konvertierung von Eagle-BRD-Dateien in Gerberdaten entstehen, übernimmt die MicroCirtec GmbH keine Haftung.

## 6. RESTRING

Um einen ausreichenden Restring bei durchkontaktierten Bohrungen gewährleisten zu können, sollte das Lötauge umlaufend 150  $\mu$  größer sein als die Bohrung.

## 7. LÖTAUGEN

Wenn nicht-durchkontaktierte Bohrungen in einem Lötauge positioniert sind, muss dieses mindestens 500  $\mu$  umlaufend größer sein, als die Bohrung. Anderenfalls können einige/alle Lötungen entfernt sein.

## 8. LÖTSTOPPMASKEN

Bei der Erstellung von Lötstoppmasken sind Lötstopp-Freistellungen im Verhältnis 1:1 zu den Pads, also ohne Oversizing (Aufweitung) zu berücksichtigen. Die MicroCirtec GmbH berechnet die für die Fertigung erforderliche Aufweitung selbst.

## 9. BESTÜCKUNGSDRUCK

Um einen einwandfreien Bestückungsdruck reproduzieren zu können, muss die Schrifthöhe mindestens 1 mm und die Strichstärke mindestens 200 µm betragen und alle Lötflächen müssen mindestens 250 µm umlaufend vom Bestückungsdruck freigestellt werden, da anderenfalls ein unsauberes Druckbild und ein Andruck der Lötflächen möglich ist.

## 10. NICHT DURCHKONTAKTIERTE BOHRUNGEN

Sind bei durchkontaktierten Leiterplatten keine Angaben über die Bohrungen vorhanden, legt die MicroCirtec GmbH nach bestem Wissen fest, welche Bohrungen durchkontaktiert und welche nicht durchkontaktiert werden.

## 11. DATEN-INKONSISTENZ

Wenn Bohr- oder Maßpläne beigelegt werden, die nicht mit den Bohrprogrammen oder der Kontur gemäß der Gerberdaten übereinstimmen, sind für die Fertigung in jedem Falle die Bohrprogramme und die Kontur gemäß der Gerberdaten verbindlich.

## 12. KONTUR DER LEITERPLATTE

Wenn nicht anders angegeben, ist für die Kontur der Leiterplatte der Mittelpunkt (= Mitte Vektor) der Konturlinien in den Gerberdaten maßgeblich. Werden Schlitzfräsungen (Slots) durch rechteckige Konturen dargestellt, geht die MicroCirtec GmbH davon aus, dass der Eckradius enthalten ist.

## 13. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Weitere technische Spezifikationen finden Sie auf unserer Homepage. Hier sind unter dem Menüpunkt LEISTUNGEN / TECHNOLOGIEN unseren „Technischen Parameter der Leiterplattenherstellung“ als Download verfügbar.

Diese technischen Standardwerte gelten auch dann, wenn von Ihnen in den Fertigungsdaten und -dokumenten andere Werte gefordert werden. Weitere technische Anforderungen die über den „Standard“ hinausgehen, sind auf Anfrage möglich.

#### **14. ROHS-KONFORMITÄT, IPC CLASS 2**

Dem Werksvertrag liegt der Qualitätsstandard gemäß IPC-A-600 Class 2 in der jeweilig gültigen Fassung zu Grunde.

Seit Februar 2004 liefert die MicroCirtec GmbH RoHS-konforme Leiterplatten in verschiedenen Oberflächenveredelungen.